文章编号:1000-7032(2014)11-1365-05

电极材料对 IGZO 薄膜晶体管性能的影响

刘 冲,韦 敏,杨 帆,贾 卓,邓 宏* (电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川成都 610054)

摘要:采用射频磁控溅射方法在n型硅片上制备了底栅顶结构的铟镓锌氧-薄膜晶体管(IGZO-TFT)。分别 采用Au、Cu、Al 3 种金属材料作为电极,研究不同电极材料对 IGZO 薄膜晶体管性能的影响。器件的输出特 性和转移特性测试结果表明:以Au 为电极的 IGZO-TFT 具有最佳的性能,其饱和输出电流达到 17.9 μA,开关 比达到 1.4×10⁶。基于功函数比较分析了 3 种电极的接触特性,根据 TLM(Transmission line model)理论推算 得出 Au 电极具有三者中最小的接触电阻。

关 键 词: IGZO; 接触电阻; TLM 理论; 功函数
 中图分类号: TN321⁺.5
 文献标识码: A
 DOI: 10.3788/fgxb20143511.1365

Effects of Electrode Materials on The Performances of IGZO-based Thin Film Transistor

LIU Chong, WEI Min, YANG Fan, JIA Zhuo, DENG Hong*

(State Key Laboratory of Electronic Thin Films and Integrated Devices, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China) * Corresponding Author, E-mail: hdeng@uestc. edu. cn

Abstract: Indium gallium zinc oxide thin film transistors (IGZO-TFTs) with bottom-gate top structure were fabricated on n-type silicon substrates using radio frequency (RF) magnetron sputtering method. Three kinds of metal material such as Au, Cu, and Al were used to fabricate electrode, respectively, and the effects of different electrode materials on IGZO TFT performance were investigated. The output characteristic and transfer characteristic of the TFT devices were tested. The best performance was obtained when Au was used to fabricate electrode, its saturation output current was 17.9 μ A, and on-off current ratio was up to 1.4×10^6 . In addition, the contact characteristics between three kinds of electrodes and IGZO thin film were analyzed based on their work function. Au electrode had the smallest contact resistance of these three metal according to the TLM(transmission line model) theory.

Key words: IGZO; contact resistance; TLM theory; work function

1引言

最近,非晶氧化物半导体(AOS)越来越受到 人们的关注。相比于非晶硅^[1]和多晶硅材料^[2], 非晶氧化物半导体具有很多明显的优势,如大的 电子迁移率、高的透光率、可以在常温下制备和良 好的均一性等^[3],使其成为下一代显示技术的关 键材料。现在,以非晶氧化物半导体为沟道的薄

基金项目:中央高校基金(ZYGX2013J041);电子薄膜与集成器件国家重点实验室基金(KFJJ201303)资助项目

收稿日期: 2014-06-16; 修订日期: 2014-09-26

膜晶体管主要有氧化锌(ZnO)基晶体管^[4]、铟锌 氧(InZnO)基晶体管^[5-6]、铟镓锌氧(IGZO)基晶 体管^[3,7]等。其中,IGZO以其优异的性能被大家 广泛研究。显示技术的发展要求驱动器件具有更 大的迁移率和更高的开关比^[8]。IGZO-TFT 具有 较大的迁移率,大迁移率意味着高饱和电流,有利 于有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)的驱 动^[9],但晶体管的饱和输出电流还要受到栅绝缘 层介电系数、沟道层材料和源漏电极等多个因素 的影响。

本文采用 IGZO 作为有源层,使用 Au、Cu、Al 3 种金属作为源漏电极制备了 a-IGZO TFTs,并讨 论了不同电极材料对 IGZO 晶体管性能的影响。 通过电学特性测试分析了 3 种电极材料的 TFT 的性能及金属电极与沟道层界面势垒,结果表明, Au 电极 TFT 具有最好的电学性能。

2 实 验

2.1 制备工艺

IGZO-TFT 采用底栅顶接触结构在 n 型硅片 制备。在重掺杂的 n 型硅片上热氧化一层 SiO₂ 作为栅介质层,厚度为 300 nm。在 n 型硅片的背 面蒸镀一层 Al 作为栅级。IGZO 薄膜采用射频磁 控溅射方法制备,靶材原子比为 Ga: In: Zn = 2:2: 1,直径为 68 mm。腔室的本底真空度在 10⁻³ Pa 以下,基板温度为室温,溅射功率为 100 W,溅射 气压为 0.45 Pa,腔室内的氩氧比为 95:5,薄膜厚 度为 80 nm。最后所制备的薄膜在空气中 450 ℃ 进行退火处理。源漏电极采用热蒸发方法生长, 通过光刻工艺得到边长为 100 µm 的正方形电极 图形。沟道的宽长比 W/L = 100 µm/20 µm。图 1 为实验所制备的 IGZO TFT 器件的结构图。



图 1 IGZO TFT 器件结构示意图 Fig. 1 Schematic structure of IGZO TFT device

2.2 测试仪器

使用日本理学公司 Rigaku D/MAX2200PC 射

线衍射仪表征 IGZO 薄膜的物相结构,使用 Nano-Map-500LS 台阶仪测量 IGZO 薄膜的厚度,使用 Agilent 4155B 半导体参数分析仪测试 IGZO-TFT 器件的电学性能。

3 结果与讨论

3.1 IGZO 薄膜特性

图 2 是在带有热氧化硅的硅片上生长的一层 IGZO 薄膜的 ESD 和 XRD 图谱。从图 2(a)中可 以看出,薄膜中 In、Ga、Zn 元素的原子比为 6:5: 3,接近于靶材的 2:2:1。图 2(b)中的 XRD 谱除 了位于 69.3°的 Si(100)峰,没有发现其他明显的 峰值,表明所制备的 IGZO 薄膜是非晶结构。



图 2 IGZO 薄膜的 EDS(a)和 XRD(b)图谱 Fig. 2 EDS (a) and XRD (b) patterns of IGZO thin film

3.2 IGZO TFT 的电学特性

图 3 是 3 种电极所对应的 IGZO-TFT 的输出 特性曲线。从图中可以看出,3 种 TFT 都具有较 好的关断和饱和特性。当 $V_{DS} = V_{CS} = 30$ V 时,Au 电极的输出电流为 17.9 μ A,大于 Al 的 3.8 μ A 和 Cu 的 13.3 μ A。可见使用 Au 电极的 TFT 拥 有更好的输出特性,更大的驱动能力,其原因是 Au 与氧化物半导体的接触电阻最小^[10-11]。

图 4 为采用 Al、Cu、Au 3 种电极材料制备的 IGZO-TFT 器件的转移特性曲线,可以看出这 3 种



图 3 Al(a)、Cu(b)、Au(c) 3 种电极的 IGZO-TFT 输出特性曲线。

Fig. 3 Output characteristics of IGZO-TFT with Al(a), Cu (b), and Au(c) as source/drain electrodes, respectively.

TFT 器件都具有较低的泄漏电流和良好的开关特性。其中,Au 电极 TFT 具有最小的关态电流和最大的饱和电流,开关比达到 1.4×10⁶。Al 电极 TFT 与 Cu 电极 TFT 的关态电流比较接近,但 Al 电极 TFT 的饱和电流较小;Cu 电极 TFT 的关态



- 图 4 Al(a)、Cu(b)、Au(c)3 种电极的 IGZO-TFT 转移特 性曲线
- Fig. 4 Transfer characteristics of IGZO-TFT with Al(a), Cu (b), and Au(c)as source/drain electrodes, respectively.

电流没有 Au 电极 TFT 小,但饱和电流比较接近。 这可能是因为电极与薄膜间 Cu 离子迁移的 影响^[12]。

根据下面的公式可以求出它的饱和迁移率, 当 $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$ 时:

$$I_{\rm DS} = \frac{\mu_{\rm sat} C_{\rm i} W}{2L} (V_{\rm GS} - V_{\rm th})^2, \qquad (1)$$

其中 I_{DS} 是缘漏极电流, C_i 是栅绝缘层单位面积电容, $W 和 L 分别是沟道的宽和长, V_{CS}$ 是栅级所加电压, V_{th} 为器件的阈值电压。求出的 Au 电极 TFT 的迁移率为 3.05 cm² · V⁻¹ · s⁻¹,高于 Al 电极 TFT 的 1.51 cm² · V⁻¹ · s⁻¹和 Cu 电极 TFT 的 2.81 cm² · V⁻¹ · s⁻¹。器件的亚阈值摆幅(SS)是表示使漏电流变化一个数量级所需要的栅极电压 增量,反应了界面态密度的大小^[13]:

$$SS = \frac{\partial V_{\rm GS}}{\partial (\log I_{\rm DS})},\tag{2}$$

表1为3种电极制备的TFT器件参数。

综合各方面性能参数分析可知,金电极 TFT 拥有最好的性能,这可能是因为金电极与半导体 界面的接触电阻小。总电阻(*R*_{on})可以通过在线 性区域的传输线性理论(TLM)求出^[14]:

表1 3种电极的 IGZO-TFT 器件参数

Table 1 Character parameters of IGZO-TFT with three kinds of source/drain electrode

电极材料	$I_{ m on}/I_{ m off}$	$V_{ m th}/{ m V}$	$SS/(V \cdot dec^{-1})$	$\mu_{\rm sat}/(~{\rm cm}^2\cdot {\rm V}^{-1}\cdot {\rm s}^{-1})$
Au	1.4×10^{6}	10.7	1.39	3.05
Cu	4.5×10^{5}	11.6	2.58	2.81
Al	1.6×10^{5}	16.1	2.08	1.51

$$R_{\rm on} = \partial V_{\rm D} / \partial I_{\rm D} = R_{\rm ch} + R_{\rm p}, \qquad (3)$$

$$R_{\rm ch} = \frac{L}{\mu_{\rm sat} C_{\rm i} W(V_{\rm GS} - V_{\rm th})}, \qquad (4)$$

其中, R_{ch} 是沟道电阻, R_p 是接触电阻。在沟道长 宽不变的情况下,可以认为 R_{ch} 是一个固定值,改 变的主要就是接触电阻 R_p 。当 $V_{CS} = 20 \text{ V}$ 、 $V_D =$ 20 V时,Au电极 TFT 的总电阻为 5.4 MΩ, Cu电 极 TFT 的总电阻为 6.6 MΩ, Al 电极 TFT 的总电 阻为 27 MΩ。可以看出 Au 电极的接触电阻最 小,与之前分析得出的结论一致。

根据 Michaelson 等^[15]的研究,得知 Au、Cu、 Al 的功函数分别为 5.1,4.65,4.28 eV。对于所 制备的有源层薄膜,这里参考 Hosono 等^[16]得出 的 IGZO 薄膜的功函数 4.5 eV,这个值与 Al 和 Cu 的功函数接近。根据金属半导体接触理论,实验 所制备的 IGZO 薄膜与 Al、Cu 应该呈现一个良好 的欧姆接触,但测试结果显示,它们类似于一个肖 特基接触。我们推断,由于 Al 和 Cu 都是比较活 泼的金属,在与 IGZO 薄膜接触时可能部分被氧 化形成了一层薄的氧化层,从而使它们之间不再 是欧姆接触而类似于肖特基接触,这也是它们的 接触电阻比 Au 大的一个原因。

4 结 论

用射频磁控溅射制备的 IGZO 薄膜为有源 层,使用3种不同的源漏电极材料制备了 IGZO-TFT 晶体管,并对薄膜质量和电学性能进行了分 析。在3种电极材料中,以Au 为电极的 TFT 电 学性能最优,开关比达 1.4×10⁶,迁移率为 3.05 cm²·V⁻¹·s⁻¹。

参考文献:

- [1] Lim W, Jang J H, Kim S H, et al. High performance indium gallium zinc oxide thin film transistors fabricated on polyethylene terephthalate substrates [J]. Appl. Phys. Lett., 2008, 93(8):082102-1-3.
- [2] Kamiya T, Mizuta H, Ahmed H, et al. Reduction of grain-boundary potential barrier height in polycrystalline silicon with hot H₂O-vapor annealing probed using point-contact devices [J]. J. Vac. Sci. Technol., 2003, 21(3):1000-1003.
- [3] Nomura K, Kamiya T, Hosono H, et al. Room-temperature fabrication of transparent flexible thin-film transistors using amorphous oxide semiconductors [J]. Lett. Nat., 2004, 432(7016):488-492.
- [4] Lim W, Kim S, Wang Y L, et al. High-performance indium gallium zinc oxide transparent thin-film transistors fabricated by radio-frequency sputtering [J]. J. Electrochem. Soc., 2008, 155(6):H383-H385.
- [5] Wang Y L, Ren F, Lim W, et al. Room temperature deposited indium zinc oxide thin film transistors [J]. Appl. Phys. Lett., 2007, 90(23):232103-1-3.
- [6] Park J S, Kim H, Heo Y W, et al. Transparent amorphous indium zinc oxide thin-film transistors fabricated at room temperature [J]. Appl. Phys. Lett., 2007, 90(2):022106-1-3.
- [7] Yabuta H, Sano M, Abe K, et al. High-mobility thin-film transistor with amorphous InGaZnO₄ channel fabricated by room temperature RF-magnetron sputtering [J]. Appl. Phys. Lett., 2006, 89(11):112123-1-3.
- [8] Kamiya T, Nomura K, Hosono H, et al. Present status of amorphous In-Ga-Zn-O thin-film transistors [J]. Sci. Technol. Adv. Mater., 2010, 11(4):044305-1-23.
- [9] Liu H Y, Sun R G. Laminated active matrix organic light-emitting devices [J]. Appl. Phys. Lett., 2008, 92(6): 063304-1-3.
- [10] Shimura Y, Nomura K, Hosono H, et al. Specific contact resistances between amorphous oxide semiconductor In-Ga-Zn-O and metallic electrodes [J]. Thin Solid Films, 2008, 516(17):5899-5902.
- [11] Na J H, Kitamura M, Arakawa Y. High field-effect mobility amorphous InGaZnO transistorswith aluminum electrodes
 [J]. Appl. Phys. Lett., 2008, 93(6):063501-1-3.
- [12] Jeong J, Kim J, Lee G J, et al. Electrical characterization of a-InGaZnO thin-film transistors with Cu source/drain electrodes [J]. Appl. Phys. Lett., 2012, 100(11):112109-1-3.
- [13] Wu W J, Yan J, Xu Z P, et al. Property comparison between IGZO TFT and ZnO TFT [J]. Chin. J. Liq. Cryst. Disp. (液晶与显示), 2011, 26(2):147-153 (in Chinese).
- [14] Ahn B D, Shin H S, Kim H J, et al. Comparison of the effects of Ar and H₂ plasmas on the performance of homojunc-

tioned amorphous indium gallium zinc oxide thin film transistors [J]. Appl. Phys. Lett. , 2008, 93(20):203506-1-3.

- [15] Herbert B. Michaelson. The work function of the elements and its periodicity [J]. J. Appl. Phys., 1977, 48(11):4729-4733.
- [16] Shimura Y, Nomura K, Hosono H, et al. Specific contact resistances between amorphous oxide semiconductor In-Ga-Zn-O and metallic electrodes [J]. Thin Solid Films, 2008, 516(11):5899-5902.



刘冲(1987 -)男,湖北天门人,硕 士研究生,2011年于武汉工程大学 获得学士学位,主要从事 IGZO-TFT 薄膜晶体管的研究。 E-mail: 397491613@qq.com



邓宏(1963 -)男,四川江油人,教授, 博士生导师,1986 年于成都电讯工程 学院(现电子科技大学)获得硕士学 位,主要从事氧化锌材料的研究。 E-mail: hdeng@uestc.edu.cn

《发光学报》

——EI 核心期刊(物理学类;无线电电子学、电信技术类)

《发光学报》是中国物理学会发光分会与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所共同主办的中国物理学会发光分会的学术会刊。该刊是以发光学、凝聚态物质中的激发过程为专业方向的综合性学术刊物。

《发光学报》于1980年创刊,曾于1992年,1996年,2000年和2004年连续四次被《中文核心期刊要 目总览》评为"物理学类核心期刊",并于2000年同时被评为"无线电电子学、电信技术类核心期刊"。 2000年获中国科学院优秀期刊二等奖。现已被《中国学术期刊(光盘版)》、《中国期刊网》和"万方数据资 源系统"等列为源期刊。英国《科学文摘》(SA)自1999年;美国《化学文摘》(CA)和俄罗斯《文摘杂志》 (AJ)自2000年;美国《剑桥科学文摘社网站》自2002年;日本《科技文献速报》(CBST,JICST)自2003年 已定期收录检索该刊论文;2008年被荷兰"Elsevier Bibliographic Databases"确定为源期刊;2010年被美国 "EI"确定为源期刊。2001年在国家科技部组织的"中国期刊方阵"的评定中,《发光学报》被评为"双效期 刊"。2002年获中国科学院2001~2002年度科学出版基金"择重"资助。2004年被选入《中国知识资源 总库·中国科技精品库》。本刊内容丰富、信息量大,主要反映本学科专业领域的科研和技术成就,及 时报道国内外的学术动态,开展学术讨论和交流,为提高我国该学科的学术水平服务。

《发光学报》自2011年改为月刊, A4 开本, 144 页, 国内外公开发行。国内定价: 40 元, 全年480 元, 全国各地邮局均可订阅。《发光学报》欢迎广大作者、读者广为利用, 踊跃投稿。

地	址:长春市东南湖大路3888号	国内统一刊号: CN 22-1116/04
	《发光学报》编辑部	国际标准刊号: ISSN 1000-7032
邮	编: 130033	国内邮发代号: 12-312
电	话:(0431)86176862,84613407	国外发行代号: 4863BM
E-n	nail: fgxbt@126.com	http://www.fgxb.org